

精密光学 BGA 返修设备 DEZ-R820

技术参数资料



DEZ-R820 精密光学返修设备的主要特点：

◆自动多模式操作控制系统及高可靠性贴装定位为一体的精密返修设备。具有贴装模式、焊接模式、拆下模式及手动可控模式，多个模式切换一键式操控；

◆精准的光学对位系统 本机的光学对位系统图像清晰，贴装精度可达 $\pm 0.01\text{mm}$ 。并且具有分光双色、放大、缩小和微调功能，配置 15" 高清液晶显示器。

◆独立三温区控温系统 ① 上下温区为热风加热，IR 预热区为红外加热，上下部发热器可从元器件顶部及 PCB 底部同时进行加热，并可同时设置多段温度控制；IR 预热区可依实际要求调整

加热面积，可使 PCB 板受热均匀。② 可对 BGA 芯片和 PCB 板同时进行热风局部加热，同时再辅以大面积的红外发热器对 PCB 板底部进行预热，能完全避免在返修过程中 PCB 板的变形；通过选择可单独使用上部温区或下部温区，并自由组合上下发热体能量。③ 选用高精度 K 型热电偶闭环控制和 PID 参数自整定系统；可同时显示四条温度曲线和存储多组用户数据，并具有瞬间曲线分析功能；外置测温接口实现对温度的精密检测，可随时对实际采集 BGA 的温度曲线进行分析和校对。

◆多功能人性化的操作系统 ① 采用高清触摸屏人机界面，该界面可设置“调试界面”和“操作界面”，以防作业中误设定；上部加热装置和贴装头一体化设计，能自动识别吸料和贴装高度，具有自动焊接和自动拆焊功能；同时温度可设置 8 段升温和 6 段恒温控制，并能储存 N 组温度设定参数，随时可根据不同 BGA 进行调用。配备多种规格钛合金 BGA 风嘴，该风嘴可 360° 任意旋转，易于安装和更换。② PCB 板定位采用 V 字型槽，定位快捷、方便、准确，满足不同 PCB 板排版方式及不同大小 PCB 板的定位；配灵活方便的可移动式万能夹具对 PCB 板起到保护作用，防止 PCB 边缘器件损伤及 PCB 变形，确保主板维修的成功率，并能适应各种 BGA 封装尺寸的返修。

◆优越的安全保护功能 本机经过 CE 认证，设有急停开关和异常事故自动断电保护装置；焊接

或拆焊完毕后具有报警功能，在温度失控情况下，电路能自动断电，拥有双重超温保护功能。

温度参数带密码保护，防止任意修改等多项安全保护及防呆功能，具有优越的安全保护功能，

确保避免在任何异常状况下返修 PCB 及元器件损坏及机器自身损毁。

DEZ-R820 返修设备的主要参数：

◆电 源：AC 220V±10% 50/60 Hz

◆总功率： Max 5300W

◆加 热 器： 上部温区 1200 W 下部温区 1200 W IR 温区 2700 W

◆电气选材：智能可编程温度控制系统。

◆温度控制：K 型热电偶闭环控制：上下独立测温，温度精准范围±1℃

◆定位方式：V 型卡槽定位+激光红点定位+万能夹具

◆PCB 尺寸：Max370×480mm Min 6×6 mm

◆适用芯片：Max 80×80mm Min 1×1 mm

◆外形尺寸：L680×W630×H900 mm

◆测温接口：1 个

◆机器重量：70kg